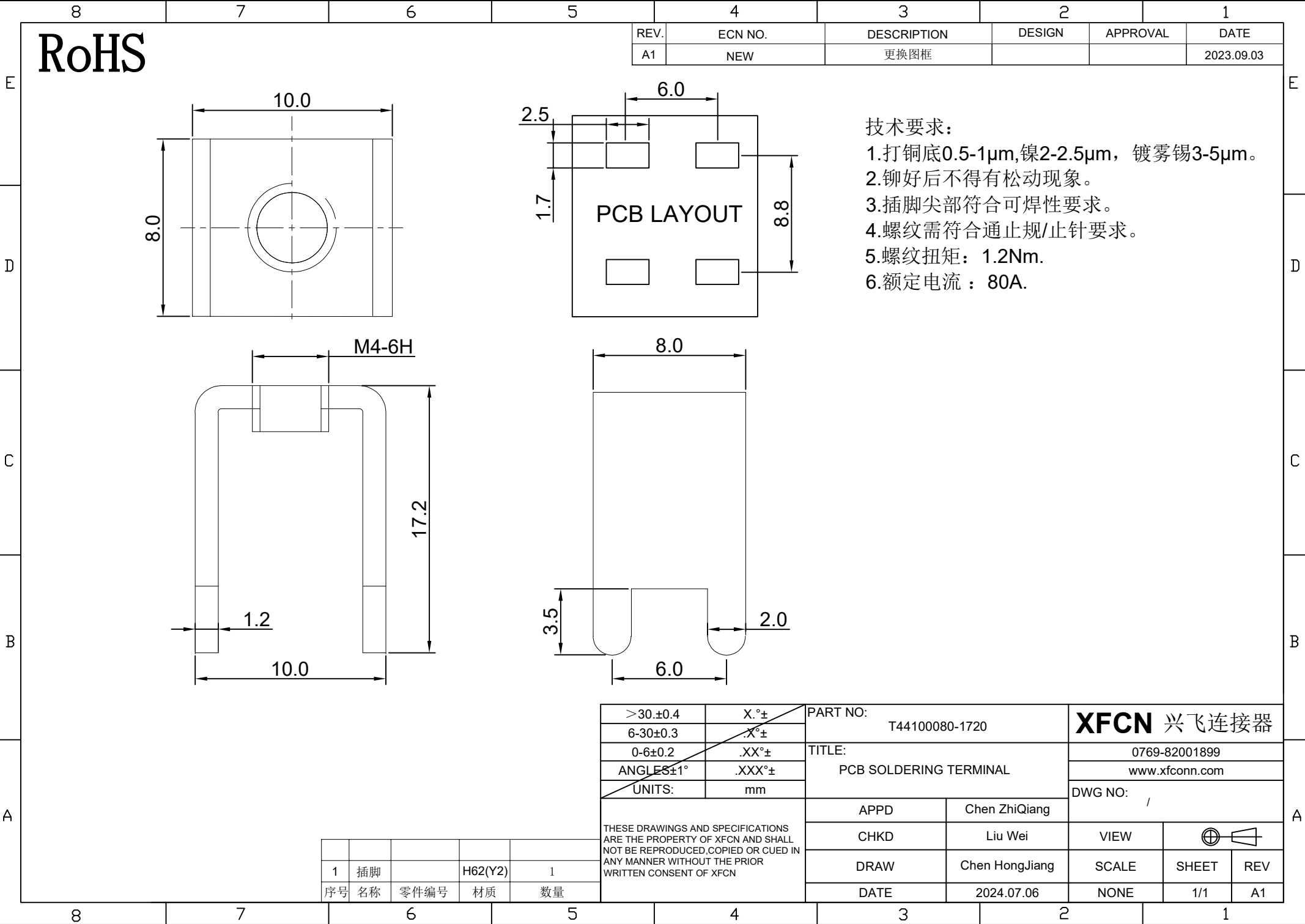




RoHS

PCB LAYOUT

- 技术要求:
- 1.打铜底0.5-1μm,镍2-2.5μm, 镀雾锡3-5μm。
 - 2.铆好后不得有松动现象。
 - 3.插脚尖部符合可焊性要求。
 - 4.螺纹需符合通止规/止针要求。
 - 5.螺纹扭矩：1.2Nm.
 - 6.额定电流：80A.

XFCN 兴飞连接器

0769-82001899

www.xfconn.com

DWG NO:

/

